

1.产品介绍

JSM700是一款内置 2 个霍尔效应元件的速度方向传感器系列。每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。

该芯片内部包括两个相距 1.63mm 的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为 3.8~30V 的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔传感器、施密特触发器和开漏输出。处理速度和方向信号很方便。

JSM700分为 T094 和 S0P8 两种封装形式, 且符合 RoHS 标准。



2.产品功能

- ▶ 霍尔元件间距 1.63mm
- ▶ 磁性类型:双极开关
- ▶ 工作电压: 3.8V~30V
- ▶ 反向电压保护
- ▶ 可驱动电流最大 30mA
- ▶ 工作温度范围: -40°C~150°C
- ➤ 灵敏度: BOP=40Gs, BRP=-40Gs
- ▶ 防静电等级高
- > 2011/65/EU

3.应用领域

- > 速度检测
- > 方向检测
- ▶ 磁性编码器

4.产品包装

产品型号	封装形式	灵敏度	成品包装
JSM700-T	T094	±40Gs	1000/袋
JSM700-S	SOP8	±40Gs	100/管

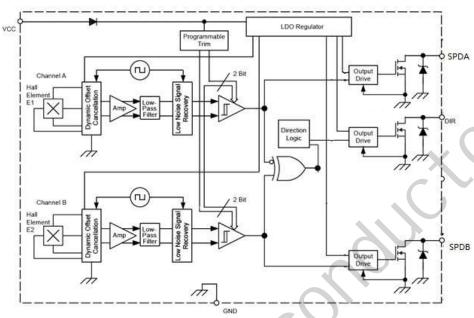


目录

1. 产品介绍	1
2. 产品功能	
3. 应用领域	1
4. 产品包装	1
5. 功能框图	3
6. 引脚信息	3
7. 绝对最大值	
8. 电气特性(T₄=25°C, V∞=5. 0V)	4
9. 磁参数定义	4
10. 输出特性	5
11. 应用电路	5
12. 封装信息	6
13. 注意事项	8



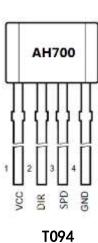
5.功能框图



6. 引脚信息

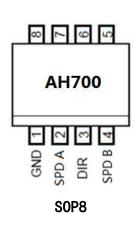
T094 引脚说明

编号	名称	描述
1	V _{cc}	电源
2	SPDA	速度 A
3	DIR	方向
	SPDB	速度 B
4	GND	地



SOP8 引脚说明

编号	名称	描述
1	GND	地
2	SPDA	速度 A
3	DIR	方向
4	SPDB	速度 B
5	NC	未定义
6	NC	未定义
7	NC	未定义
8	VCC	电源





7.绝对最大值

绝对最大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响

参数	符号	最小值	最大值	单位
电源电压	V _{cc}	-0.5	15	V
输出电压	V _{out}	-0.5	15	V
输出电流	I _{out}	0	5	mA
操作温度范围	T _A	-40	150	°C
储存温度范围	Ts	-50	165	°C

8.电气特性(T_A=25°C, V_{CC}=5. 0V)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vcc	Operating	3. 8	5	30	V
工作电流	Is	B <brp< td=""><td></td><td>8</td><td></td><td>mA</td></brp<>		8		mA
饱和电压	V _{SAT}	B=250Gs, R _L =10Kohms			0. 4	V
输出漏电流	loff	B <brp, Vout=24V</brp, 		0. 1	1	uA
上升时间	T_{R}	R _L =10Kohms, CL=20pF			1	uS
下降时间	T_{\scriptscriptstyleF}	R_L =10Kohms, CL=20pF			1	uS
工作点	Вор	T _A =25°C	10	40	70	Gs
释放点	Brp	T _A =25°C	-70	-40	-10	Gs
回差	Bhys	T _A =25degC, Bhys=Bop-Brp		80		Gs
两个霍尔距 离	Dis			1. 63		mm

9. 磁参数定义

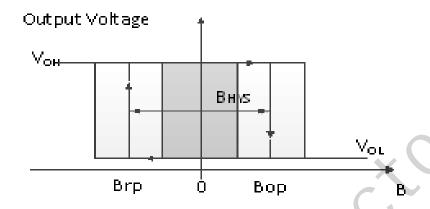
BOP: 工作点, 在封装标记面施加磁通密度, 输出驱动器开(Vour=低)

BRP: 释放点, 在封装标记面施加磁通密度, 输出驱动器关(Vour=高)

BHYST: 滞回窗口 | BOP-BRP |

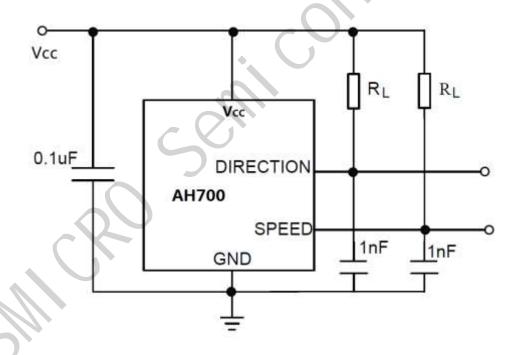


10. 输出特性



11.应用电路

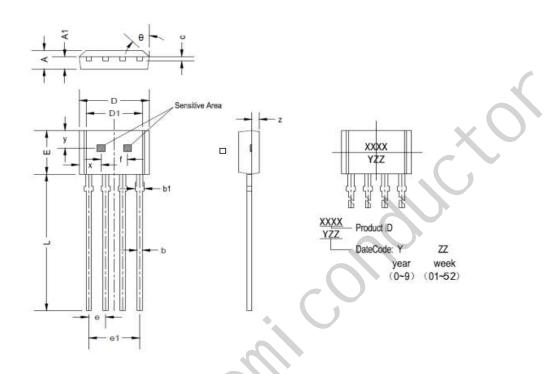
注意: R_L推荐 1Kohm~10Kohm





12.封装信息

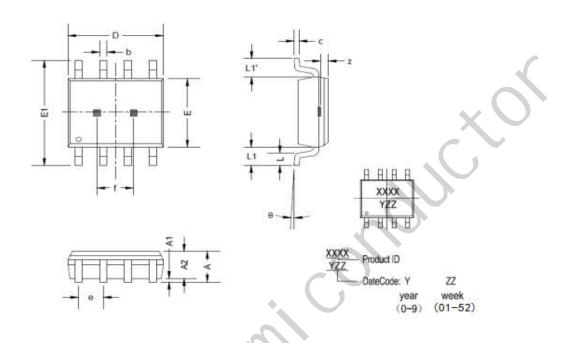
T094 封装尺寸



符号	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
10 2	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1. 420	1. 660	0. 056	0. 065
A1	0. 660	0. 860	0. 026	0. 034
b	0. 350	0. 480	0. 014	0. 019
b1	0. 400	0. 650	0. 016	0. 026
С	0. 360	0. 510	0. 014	0. 020
D	5. 100	5. 300	0. 201	0. 208
D1	4. 100	4. 300	0. 161	0. 169
E	3. 550	3. 750	0. 140	0. 147
е	1. 267	1. 273	0. 050	0. 050
e1	3. 780	3. 840	0. 149	0. 151
L	13. 500	15. 500	0. 531	0. 610
f	1. 390	1. 410	0. 055	0. 056
х	1.800	2. 000	0. 071	0. 079
z	0. 500TYP		0. 020TY	Р
θ	10°	12°	10°	12°



SOP8 封装尺寸



符号	尺寸(毫米)	尺寸(英寸)		
	最小值	最大值	最小值	最大值	
А	A	1. 350	1. 750	0. 530	
A 1	A1	0. 100	0. 250	0. 004	
A2	A2	1. 350	1. 550	0. 053	
b	b	0. 330	0. 510	0. 013	
G	С	0. 170	0. 250	0. 007	
D	D	4. 800	5. 000	0. 189	
е	1. 270 (BSC)		1.270 (BSC)		
E	5. 800	6. 200	0. 228	0. 224	
E1	3. 800	4. 000	0. 150	0. 157	
L	0. 400	1. 270	0. 016	0. 050	
θ	0°	8°	0°	8°	



13.注意事项

- ▶ 霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。
- ▶ 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。
- ▶ 建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。
- > 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。